

圖 13-29 典型接面漏電流與崩潰電壓測試結果。

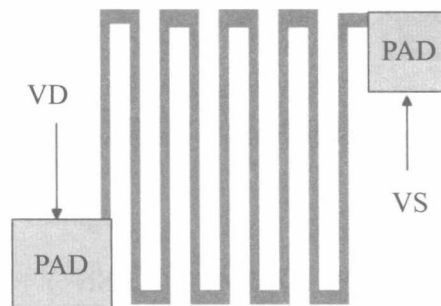


圖 13-30 典型測量電路連續性測試鍵。

Measure  $I_D$  with  $V_D = V_{CC}$ ,  $V_S = 0V$

## 2. 不同層間連續性-疊層接觸窗／通孔 (Stack contact/via)

為了檢視不同金屬層之間的連續性，可以將接觸窗／通孔疊層形成鏈狀結構，量測方法與串接式的接觸窗／通孔結構相同，根據量測到的阻值差異用來判斷不同金屬層之間的製程異常。設計守則中的金屬線或多晶矽線的延伸 (Extension) 及接觸窗／通孔的重疊 (Overlap)，其目的都是為了檢視不同層之間電路的連續性。